公司代码：688008　　公司简称：澜起科技

澜起科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司的总股本 1,132,824,111 股，其中回购专用账户的股数为 3,873,000 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 1,128,951,111 股，合计拟派发现金红利 338,685,333.30 元（含税）。此外，2021 年度，公司通过集中竞价方式回购股份的金额为 300,020,229.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综上，本年度公司涉及现金分红的总额为 638,705,562.86 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 77.03%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	澜起科技	688008	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	傅晓	孔旭
办公地址	上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6	上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6
电话	021-5467 9039	021-5467 9039
电子信箱	ir@montage-tech.com	ir@montage-tech.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，目前公司拥有两大产品线，互连类芯片产品线和津速•服务器平台产品线。其中，互连类芯片产品主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片，津速•服务器平台产品包括津速•CPU 和混合安全内存模组（HSDIMM•）。同时，公司正在研发 AI 芯片。

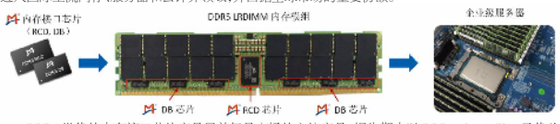
★ 互连类芯片产品线

1、内存接口芯片

内存接口芯片是服务器内存模组（又称“内存条”）的核心逻辑器件，作为服务器 CPU 存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。内存接口芯片需与内存厂商生产的各种内存颗粒和内存模组进行配套，并通过服务器 CPU、内存和 OEM 厂商针对其功能和性能（如稳定性、运行速度和功耗等）的全方位严格认证，才能进入大规模商用阶段。因此，研发此类产品不仅要攻克内存接口的核心技术难关，还要跨越服务器生态系统的高准入门槛。

现阶段，DDR4 及 DDR5 内存接口芯片按功能可分为两类：一是寄存缓冲器（RCD），用来缓冲来自内存控制器的地址、命令，控制信号；二是数据缓冲器（DB），用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号。RCD 与 DB 组成套片，可实现对地址、命令、控制信号和数据信号的全缓冲。仅采用了 RCD 芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组通常称为 RDIMM（寄存双列直插内存模组），而采用了 RCD 和 DB 套片对地址、命令、控制信号及数据信号进行缓冲的内存模组称为 LRDIMM（减载双列直插内存模组）。

公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，长期致力于为新一代服务器平台提供符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案。随着 JEDEC 标准和内存技术的发展演变，公司先后推出了 DDR2 – DDR5 系列内存接口芯片，可应用于各种缓冲式内存模组，包括 RDIMM 及 LRDIMM 等，满足高性能服务器对高速、大容量的内存系统的需求。目前，公司的 DDR4 及 DDR5 内存接口芯片已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，并占据全球市场的重要份额。



DDR4 世代的内存接口芯片产品目前仍是市场的主流产品，报告期内以 DDR4 Gen2 Plus 子代为主。公司 DDR4 内存接口芯片子代产品及其应用情况如下：

DDR4 内存接口芯片产品	应用
Gen1.0 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2133
Gen1.0 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2133
Gen1.5 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2400
Gen1.5 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2400
Gen2 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2666
Gen2 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2666
Gen2 Plus DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM，LRDIMM 和 NVDIMM，支持速率达 DDR4-3200
Gen2 Plus DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-3200

DDR5 是 JEDEC 标准定义的第 5 代双倍速率同步动态随机存取存储器标准。与 DDR4 相比，DDR5 采用了更低的工作电压（1.1V），同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步，其支持的最高速率可能超过 6400MT/s，是 DDR4 最高速率的 2 倍以上。

2021 年第四季度，公司研发的 DDR5 第一子代内存接口芯片成功实现量产。公司 DDR5 内存接口芯片产品及其应用情况如下：

DDR5 内存接口芯片产品	应用
Gen1.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR5-4800
Gen1.0 DDR5 DB 芯片	DDR5 LRDIMM，支持速率达 DDR5-4800

（1）DDR5 第一子代 RCD 芯片支持双通道内存架构，命令、地址和控制信号 1:2 缓冲，并提供奇偶校验功能。该芯片符合 JEDEC 标准，支持 DDR5-4800 速率，采用 1.1V 工作电压，更为节能。该款芯片除了可作为中央缓冲器单独用于 RDIMM 之外，还可以与 DDR5 DB 芯片组成套片，用于 LRDIMM，以提供更高容量、更低功耗的内存解决方案。

（2）DDR5 第一子代 DB 芯片是一款 8 位双向数据缓冲芯片，该芯片与 DDR5 RCD 芯片一起组成套片，用于 DDR5 LRDIMM。该芯片符合 JEDEC 标准，支持 DDR5-4800 速率，采用 1.1V 工作电压。在 DDR5 LRDIMM 应用中，一颗 DDR5 RCD 芯片需搭配十颗 DDR5 DB 芯片，即每个子通道配置五颗 DB 芯片，以支持片上数据校正，并可将数据预取提升至最高 16 位，从而为高端多核服务器提供更大容量、更高带宽和更强性能的内存解决方案。

2、DDR5 内存模组配套芯片

根据 JEDEC 标准，DDR5 内存模组上除了内存颗粒及内存接口芯片外，还需要三种配套芯片，分别是串行检测集线器（SPD）、温度传感器（TS）以及电源管理芯片（PMIC）。

2021 年第四季度，公司与合作伙伴共同研发的 DDR5 第一子代内存模组配套芯片成功实现量产。公司 DDR5 内存模组配套芯片产品及其应用情况如下：

DDR5 内存模组配套芯片产品	应用
DDR5 SPD	DDR5 RDIMM、LRDIMM、UDIMM 和 SODIMM
DDR5 TS	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM
DDR5 PMIC（低 / 高电流）	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM

（1）串行检测集线器（SPD）

公司与合作伙伴共同研发了 DDR5 第一子代串行检测集线器（SPD），芯片内部集成了 8Kbit EEPROM、I2C/I3C 总线集线器（Hub）和温度传感器（TS），适用于 DDR5 系列内存模组（如 LRDIMM、RDIMM、UDIMM、SODIMM 等），应用范围包括服务器、台式机及笔记本内存模组。SPD 是 DDR5 内存模组不可或缺的组件，也是内存管理系统的关键组成部分，其包含如下几项功能：

第一，其内置的 SPD EEPROM 是一个非易失性存储器，用于存储内存模组的相关信息以及模组上内存颗粒和相关器件的所有配置参数。根据 JEDEC 的内存规范，每个内存模组都需配置一个 SPD 器件，并按照 JEDEC 规范的数据结构编写 SPD EEPROM 的内容。主板 BIOS 在开机启动读取 SPD 内存储的信息，并根据读取到的信息来配置内存控制器和内存模组。DDR5 SPD 数据可通过 I2C/I3C 总线访问，并可按存储区块（block）进行写保护，以满足 DDR5 内存模组的高速率和安全要求。

第二，该芯片还可以作为 I2C/I3C 总线集线器，一端连接系统主控设备（如 CPU 或基板管理控制器（BMC）），另一端连接内存模组上的本地组件，包括 RCD、PMIC 和 TS，是系统主控设备与内存模组上组件之间的通信中心。在 DDR5 规范中，一个 I2C/I3C 总线上最多可连接 8 个集线器（8 个内存模组），每个集线器和该集线器管理下的每个内存模组上的本地组件都被指定了一个特定的地址代码，支持唯一地址固定寻址。

第三，该芯片还内置了温度传感器（TS），可连续监测 SPD 所在位置的温度。主控设备可通过 I2C/I3C 总线从 SPD 中的相关寄存器读取传感器检测到的温度，以便于进行内存模组的温度管理，提高系统工作的稳定性。

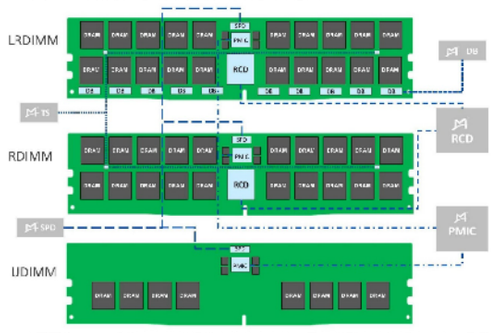
（2）温度传感器（TS）

公司与合作伙伴共同研发了 DDR5 第一子代高精度温度传感器（TS）芯片，该芯片符合 JEDEC 规范，支持 I2C 和 I3C 串行总线，适用于 DDR5 服务器 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。TS 作为 SPD 芯片的从设备，可以工作在时钟频率分别高达 1MHz I2C 和 12.5MHz I3C 总线上；CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯，从而实现对内存模组的温度管理。TS 是 DDR5 服务器内存模组上重要组件，目前主流的 DDR5 服务器内存模组配置 2 颗 TS。

（3）电源管理芯片（PMIC）

公司与合作伙伴共同研发了符合 JEDEC 规范的 DDR5 第一子代低 / 高电流电源管理芯片（PMIC），该芯片包含 4 个直流–直流降压转换器，两个线性稳压器（LDO，分别为 1.8V 和 1.0V），并能支持 I2C 和 I3C 串行总线，适用于 DDR5 服务器 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。PMIC 的作用主要是为内存模组上的其他芯片（如 DRAM、RCD、DB、SPD 和 TS 等）提供电源支持。CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯，从而实现电源管理。低电流电源管理芯片应用于 DDR5 服务器较小电流的 RDIMM 内存模组，高电流电源管理芯片则应用于 DDR5 服务器较大电流的 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。

公司 DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片示意图如下：



公司可为 DDR5 系列内存模组提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案，是目前全球可提供全套解决方案的两家公司之一。

3、PCIe Retimer 芯片

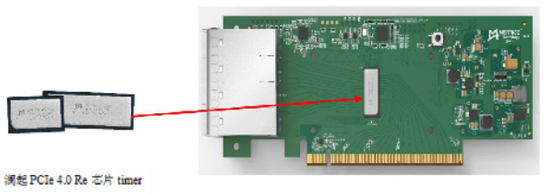
PCIe Retimer 芯片是适用于 PCIe 高速数据传输协议的超高速时序整合芯片，这是公司在全互连芯片领域布局的一款重要产品。

近年来，高速数据传输协议已由 PCIe 3.0（数据速率为 8GT/S）发展为 PCIe 4.0（数据速率为 16GT/S），数据传输速度翻倍的同时带来了突出的信号衰减和参考时钟时序重整问题，这些问题较大限制了超高速数据传输协议在下一代计算平台的应用范围。PCIe 4.0 的高速传输问题提高了对优化高速电路与系统互连的设计需求，加大了在超高速传输下保持信号完整性的研发热度。为了补偿高速信号的损耗，提升信号的质量，通常会在链路中加入超高速时序整合芯片（Retimer）。PCIe Retimer 芯片已成为高速电路的重要器件之一，主要解决数据中心数据高速、远距离传输时，信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题。

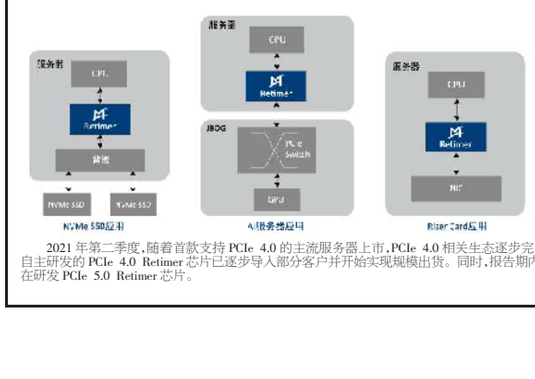
2020 年公司研发的 PCIe 4.0 Retimer 芯片成功量产，该芯片采用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种扭动源的影响，从而提升信号完整性，增加高速信号的有效传输距离，为服务器、存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能 PCIe 互连解决方案。该系列 Retimer 芯片符合 PCIe 4.0 基本规范，支持业界主流封装、功耗和传输延时等关键性能指标达到国际先进水平，并已与 CPU、网卡、固态硬盘、GPU 和 PCIe 交换芯片等进行了广泛的互操作测试。

公司 PCIe 4.0 Retimer 芯片产品及其应用情况如下：

PCIe 4.0 Retimer 芯片产品	应用
8 通道 PCIe 4.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器
16 通道 PCIe 4.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器



公司的 PCIe 4.0 Retimer 芯片可应用于 NVMe SSD、AI 服务器、Riser 卡等典型应用场景，同时，公司提供基于该款芯片的参考设计方案，评估板及配套软件等完善的技术支持服务，帮助客户快速完成导入设计，缩短新产品上市周期。PCIe 4.0 Retimer 芯片的典型应用场景图示如下：



2021 年第二季度，随着首款支持 PCIe 4.0 的主流服务器上市，PCIe 4.0 相关生态逐步完善，公司自主研发的 PCIe 4.0 Retimer 芯片已逐步导入部分客户并开始实现规模出货。同时，报告期内公司正在研发 PCIe 5.0 Retimer 芯片。

★ 津速•服务器平台产品线

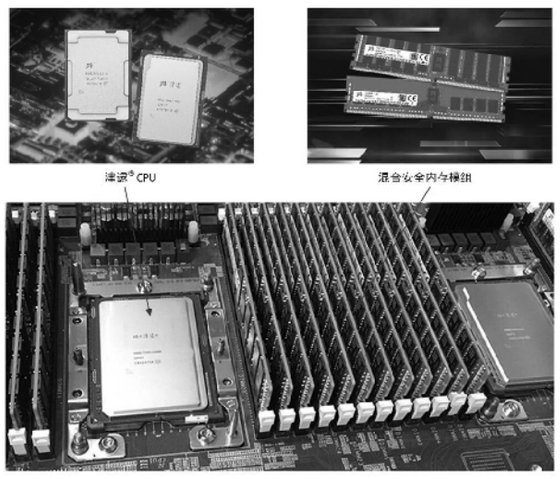
津速•服务器平台主要由澜起科技的津速•CPU 和混合安全内存模组（HSDIMM•）组成。该平台具备芯片级实时安全监控功能，可在信息安全领域发挥重要作用，为云计算数据中心提供更为安全、可靠的运算平台。此外，该平台还融合了先进的异构计算与互联技术，可为大数据及人工智能时代的各种应用提供强大的综合数据处理及计算力支撑。

1、津速•CPU

津速•CPU 是公司推出的一系列具有预检测、动态安全监控功能的 x86 架构处理器，适用于津速•或其他通用的服务器平台。报告期内，公司持续更新迭代，推出了更高性能的第三代津速•CPU 产品，旨在满足服务器市场对 CPU 性能和安全性日益提升的需求。相较上一代产品，第三代津速•CPU 采用先进的 10nm 制程工艺，支持 64 通道 PCIe 4.0，最高支持 8 通道 DDR4-3200 内存，单插槽最大容量 6TB。其最高核心数为 28 核，最高基频为 3.1GHz，最大共享缓存为 42MB，实现了较大幅度的性能提升。此外，第三代津速•CPU 显著提升了各种标准的加解密、验签、数据完整性等密码应用的运算性能；丰富了内存保护机制，可对不同内存区域或内存全域进行加密保护；内置增强型深度学习加速技术，带来了更为出色的人工智能推理和训练能力。该款服务器 CPU 支持公司独有的安全预检测（PrC）技术，可在公司认证的可信环境中对处理器行为进行安全预检测，以排查预定应用场景下的处理器异常行为，从而保障处理器的安全，特别适用于金融、交通、政务、能源等对硬件安全要求较高的行业。

2、混合安全内存模组（HSDIMM•）

混合安全内存模组采用公司具有自主知识产权的 Mont-ICMT•（Montage, Inspection & Control on Memory Traffic）内存监控技术，可为服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。目前，公司推出两大系列混合安全内存模组：标准版混合安全内存模组（HSDIMM•）和精简版混合安全内存模组（HSDIMM•-Lite），可为不同应用场景提供不同级别的数据安全解决方案，为各大数据中心及云计算服务器等提供了基于内存端的硬件级数据安全解决方案。



津速•服务器平台主要针对中国本土市场，截至目前，已有多家服务器厂商采用津速•服务器平台相关产品，开发出了系列高性能且具有独特安全功能的服务器机型。这些机型已应用到政务、交通等领域及高科技企业中，为用户实现了计算资源池的无缝升级和扩容，在保障强劲运算性能的同时，更为用户的数据、信息安全保驾护航。

★ AI 芯片

1、AI 芯片解决方案概述

公司在研的 AI 芯片解决方案由 AI 芯片等相关硬件及相应的适配软件构成，采用了近内存计算架构，主要用于解决 AI 计算在大数据吞吐下推理应用场景中存在的 CPU 带宽、性能瓶颈及 GPU 内存容量瓶颈问题，为客户提供低延时、高效率的 AI 计算解决方案。

AI 芯片是上述解决方案的核心硬件，主要由 AI 计算子系统、CXL 控制器、DDR 内存控制器等模块组成，其中 AI 计算子系统具有较强的可扩展性，包含了 DSP Cluster 和 AI Core Cluster，DSP 支持通用向量计算，AI Core 支持矩阵和张量计算。该芯片面向大数据场景下 AI 的应用进行了针对性设计，集成了 AI 高性能计算、异构计算、CXL 高速接口技术、DDR 内存控制技术等相关技术，有效地减少了 AI 数据搜索和排序等高效的硬件加速功能，并且兼具数据压缩和数据加解密等功能。

同时，公司在 AI 芯片解决方案软支持完善的 AI 软件生态，能够针对性地对各类 AI 算法和模型进行软硬件联合深度优化，可支持业内主流的各类神经网络模型，比如视觉算法、自然语言处理和推荐系统等方向，有利于后续软硬件生态建设及市场推广工作。

2、AI 芯片未来典型应用场景

公司在研的 AI 芯片未来的典型应用场景如下：

（1）互联网领域大数据吞吐下的推荐系统。目前业界常规方案是将推荐系统中“Embedding（向量化）”、“Embedding Search（向量搜索）”两个主要步骤分别交由不同平台计算平台处理，由高算力的 GPU、FPGA 或 ASIC 芯片负责“Embedding”部分，由 CPU+大数据系统部署“Embedding Search”部分，这种步骤分割，产生大量的数据交换，并且由于硬件的限制，存在搜索效率的瓶颈。公司 AI 芯片的目标是整合上述两个步骤，同时平衡算力和内存容量，使计算资源和内存得以高效利用，解决系统的效率瓶颈问题。

（2）医疗领域生物医学/医疗大图片流处理。目前业界常规方案是在 CPU 中对大图片进行切割，切割获取的子图通过 PCIe 接口被传送到 GPU 进行 AI 处理；通过多次交互，最终实现一张大图的处理，该方案下同样受到二者之间的接口带宽及其内存的限制。公司的 AI 芯片可大幅提升内存容量，减少甚至无需图片切割，同时 CXL 接口可以充分利用 cache 性能，并直接访问近内存计算模组的 DDR 内存，从而提升总的效率。

（3）人工智能物联网领域的大数据应用场景。

总体来说，公司 AI 芯片解决方案的目标是在类似上述应用场景下，相较于传统方案，可以为客户提供更有效率、更具性价比的解决方案。

3、AI 芯片的技术先进性

在 AI 芯片解决方案的研发过程中，公司自主研发及系统整合了一系列关键的核心技术，攻克了在大数据高性能计算场景下存在的内存墙的技术难点，支持异构多核、高速稳定的互连互通以及与 x86 软硬件生态的无缝兼容，提升了 AI 推理计算和大数据吞吐应用场景下的运算效率。其技术先进性主要体现在：

（1）AI 芯片整体架构采用“基于 CXL 协议的近内存计算”这一创新的架构，旨在解决数据中心的 AI 推理计算和大数据融合的业务场景下多方面用户痛点和技术难点；

（2）AI 计算引擎模块为交互计算的异构计算系统，同时融合高速 SRAM 及自主研发硬件加速器，并兼备灵活的可编程多核异构设计思路，可同时进行处理命令和数据的高速交互，提高了运算效率；

（3）公司的 CXL 控制器可实现 CPU 与 AI 芯片的高速交互，提供了大容量数据搜索和排序等高效的硬件加速功能，并且兼具数据压缩和数据加解密等特色功能；

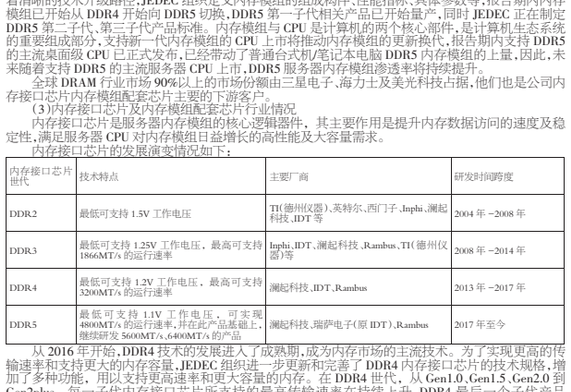
（4）完善的 AI 软件生态，能够针对性地对各类 AI 算法和模型进行软硬件联合深度优化，适用于业内主流的各类神经网络模型，并与主流软件框架的完全兼容和无缝对接；

（5）自研的灵活可多维扩展的高性能计算核心具备模块设计的理念，有利于 AI 芯片后续不断迭代升级。

（二）主要经营模式

公司是一家集成电路设计企业，自成立以来公司经营模式均为行业里的 Fabless 模式，该模式下，公司专注于从事产业链中的集成电路设计和营销环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，由公司取得/测试后芯片成品销售给客户。

在 Fabless 模式下，产品设计与研发环节属于公司经营的核心，由多个部门参与执行。芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务。具体地，公司产品的业务流程示意图如下：



上述流程图中项目提案、市场要求定义、启动会议、初始技术规范、架构设计、模块设计、全芯片设计评审、终版技术规范审议、流片评审、样片验证、可靠性评估、产品特性验证、系统确认、产品提交量产、销售等环节主要由公司完成，其余环节主要由委外厂商完成。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家集成电路设计企业，集成电路行业作为全球信息产业的基础，是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如 PC、互联网、智能手机、数字图像、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中必不可少的组成部分。移动互联时代后，5G、云计算、AI 计算、高性能计算、智能汽车等应用领域的快速发展和技术迭代，正推动集成电路产业进入新的成长周期。

集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，属于资本与技术密集型行业。根据美国半导体行业协会（Semiconductor Industry Association）的统计数据，2021 年全球芯片销量和销售额均创历史新高，其中销售额达到 5559 亿美元，同比增长 26.2%。根据中国半导体行业协会统计的数据，2021 年中国集成电路设计业销售额为 4519 亿元，较 2020 年增长 19.6%。

（1）服务器市场行业情况

公司主要产品为内接口及模组配套芯片，PCIe Retimer 芯片、津速•CPU 以及混合安全内存模组均应用于服务器，因此，服务器行业的发展情况与公司业务紧密相关。服务器是数据中心的“心脏”，其本质是一种性能更高的计算机，但相较于普通计算机，服务器具有更高速的 CPU 计算能力、更强大的外部数据吞吐能力和更好的扩展性，运行更快、负载更高。基于全球数据总量的爆发式增长以及数据向云端迁移的趋势，新的数据中心建设热度不减，同时围绕新增数据的处理和应用，云计算、人工智能、虚拟现实和增强现实等数字经济方兴未艾，服务器作为基础的算力支撑，从长远来看，整体服务器市场将持续保持高景气度。

2021 年全球服务器市场在需求端呈现供不应求态势，主要原因是疫情反复带动云端、家庭办公和线上服务需求，大型云端企业对服务器采购强劲；但在供给端由于芯片、零部件短缺使供应进度受阻，两种因素叠加使得 2021 年全球服务器市场同比实现个位数增长。根据 IDC 的研究报告，2021 年全球服务器市场出货量和销售额分别为 1,353.9 万台和 992.2 亿美元，同比增长 6.9%和 6.4%。

2021 年中国服务器市场保持高速增长态势，得益于“数字中国”、“东数西算”等战略的出台，特别是《十四五规划》纲要中，明确提出数字经济核心产业增加值占 GDP 比重将从 2020 年的 7.8%增加到 2025 年的 10%，预计将为中国服务器市场未来几年的发展带来巨大的推进作用，随着国产品牌的竞争实力不断加强，国产品牌的服务器相关产品将在中国服务器市场享受更多的成长红利。根据 IDC 的研究报告，2021 年中国服务器市场出货量和销售额分别为 391.1 万台和 250.9 亿美元，同比增长 8.4%和 12.7%。

（2）内存模组行业情况

内存模组是当前计算机架构的重要组成部分，作为 CPU 与硬盘的数据中转站，起到临时存储数据的作用，其存储和读取数据的速度相较硬盘更快。按应用领域不同，内存模组可分为：1、服务器内存模组，其主要类型为 RDIMM、LRDIMM，相较于其他类型内存模组，服务器内存模组由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升，对内存模组的稳定性、纠错能力以及低功耗均提出了较高要求；2、普通台式机、笔记本内存模组，其主要类型为 UDIMM、SODIMM。而平板、手机内存主要使用的 LPDDR 通过焊接至主板或封装在片上系统上发挥功能。

内存模组行业的发展主要来自于技术的更新迭代和计算机生态系统的推动。内存模组的发展有着清晰的技术升级路径，JEDEC 组织定义内存模组的组成构件、性能指标、具体参数等，报告期内内存模组已开始从 DDR4 开始向 DDR5 切换，DDR5 第一子代相关产品已开始量产，同时 JEDEC 正在制定 DDR5 第二子代、第三子代产品标准。内存模组与 CPU 是计算机的两个核心部件，是计算机生态系统的重要组成部分，支持新一代内存模组的 CPU 上市将推动内存模组的更新换代，报告期内支持 DDR5 的主流桌面级 CPU 已正式发布，已经带动了普通台式机/笔记本电脑 DDR5 内存模组的上量，因此，未来随着支持 DDR5 的主流服务器 CPU 上市，DDR5 服务器内存模组渗透率将持续提升。

全球 DRAM 行业市场 90%以上的市场份额由三星电子、海力士及美光科技占据，他们也是公司内存接口芯片内存模组配套芯片主要的下游客户。

（3）内存接口芯片及内存模组配套芯片行业情况

内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

内存接口芯片的发展演变情况如下：

内存接口芯片世代	技术特点	主要厂商	研发时间跨度
DDR2	最低可支持 1.5V 工作电压	TI（德州仪器）、英特尔、西门子、Inphi、澜起科技、IDT 等	2004 年 –2008 年
DDR3	最低可支持 1.25V 工作电压，最高可支持 1866MT/s 的运行速率	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、TI（德州仪器）等	2008 年 –2014 年
DDR4	最低可支持 1.2V 工作电压，最高可支持 3200MT/s 的运行速率	澜起科技、IDT、Rambus	2013 年 –2017 年
DDR5	最低可支持 1.1V 工作电压，可实现 4800MT/s 的运行速率，并在此产品基础上，继续研发 5600MT/s、6400MT/s 的产品	澜起科技、瑞萨电子（原 IDT）、Rambus	2017 年至今

从 2016 年开始，DDR4 技术的发展进入了成熟期，成为内存市场的主流技术。为了实现更高的传输速率和支持更大的内存容量，JEDEC 组织进一步更新和完善了 DDR4 内存接口芯片的技术规格，增加了多种功能，用以支持更高速率和更大容量的内存。在 DDR4 世代，从 Gen1.0、Gen1.5、Gen2.0 到 Gen2plus，每一子代内存接口芯片所支持的最高传输速率在持续上升，DDR4 最后一个子代产品 Gen2plus 支持的最高传输已达 3200MT/s。随着 JEDEC 组织不断完善对 DDR5 内存接口产品的规格定义，DDR5 内存技术正在逐步实现对 DDR4 内存技术的更新和替代。DDR5 第一子代内存接口芯片相比于 DDR4 最后一个子代的内存接口芯片，采用了更低的工作电压（1.1V），同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步。从 JEDEC 已经公布的相关信息来看，DDR5 内存接口芯片已经规划了三个子代，支持速率分别是 4800MT/s、5600MT/s、6400MT/s，预计后续可能还会有 1–2 个子代，可见通过不断的技术创新，实现更高的传输速率和支持更大的内存容量将是内存接口芯片行业未来发展的趋势和动力。

根据 JEDEC 组织的定义，在 DDR5 世代，服务器内存模组上除了需要内存接口芯片之外，同时还需要配置三种配套芯片，包括一颗 SPD 芯片、一颗 PMIC 芯片和两颗 TS 芯片；普通台式机、笔记本电脑的内存模组 UDIMM、SODIMM 上，需要配置两种配套芯片，包括一颗 SPD 芯片和一颗 PMIC 芯片。

目前 DDR5 内存接口芯片的竞争格局与 DDR4 世代类似，全球只有三家供应商可提供 DDR5 第一子代的量产产品，分别是公司、瑞萨电子和 Rambus，公司在内存接口芯片的市场份额保持稳定。在配套芯片上，SPD 和 TS 目前主要的两家供应商是公司和瑞萨电子；PMIC 的竞争对手更多，在初期竞争会更复杂。

（4）PCIe 及 PCIe Retimer 芯片行业情况

PCIe 协议是一种高速串行计算机扩展总线标准，自 2003 年诞生以来，近几年 PCIe 互连技术发展迅速，传输速率基本上实现了每 3–4 年翻倍增长，并保持良好的向后兼容特性。PCIe 协议由 PCIe 3.0 发展为 PCIe 4.0，传输速率已从 8GT/s 提升到 16GT/s，到 PCIe 5.0、PCIe 6.0，传输速率将进一步提升到 32GT/s、64GT/s。随着 PCIe 协议传输速率的快速提升，并依托于强大的生态系统，平台厂商、芯片厂商、终端设备厂商和测试设备厂商的深入合作，PCIe 已成为主流互连接口，全面覆盖了包括 PC 机、服务器、存储系统、手持计算等各种计算平台，有效服务云计算、企业级计算、高性能计算、人工智能和物联网等应用场景。

然而，一方面随着应用不断发展推动着 PCIe 标准迭代更新，速度不断翻倍，另一方面由于服务器的物理尺寸受限于工业标准并没有很大的变化，导致整个链路的插损预算从 PCIe3.0 时代的 22dB 增加到了 PCIe 4.0 时代的 28dB，并进一步增长到了 PCIe 5.0 时代的 36dB。如何解决 PCIe 信号链路的插损问题，提高 PCIe 信号传输距离是业界面临的重要问题。

一种思路是选用低损 PCB，但价格高昂，仅仅是主板就可能会带来较大的成本增加，而且并不能有效覆盖多连接器应用场景；另一种思路是引入适当的链路扩展器件如 Retimer，使用 PCIe Retimer 芯片，采用模拟信号和数字信号调理技术，重定时技术，来补偿信道损耗并消除各种扭动的影响，从而提升 PCIe 信号的完整性，增加高速信号的有效传输距离。

因此，PCIe Retimer 芯片作为 PCIe 协议升级迭代背景下新的芯片需求，其主要解决数据中心、服务器通过 PCIe 协议在数据高速、远距离传输时，信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题。相比于市场其他技术解决方案，现阶段 Retimer 芯片的解决方案在性能、标准化和生态系统支持等方面具有一定的比较优势，未来根据系统配置，Retimer 芯片可以灵活地切换 PCIe 或 CXL 模式，更受用户青睐。

而随着传输速率从 PCIe 4.0 的 16GT/s 到 PCIe 5.0 的 32GT/s，再次实现翻倍，Retimer 芯片技术路径的优势更加明显，Retimer 芯片的需求呈“刚性化”趋势。有研究预测，到 PCIe 5.0 时代，PCIe Retimer 芯片有望为行业主流解决方案。

（5）AI 芯片行业情况

报告期内 AI 行业和市场继续快速发展，除了传统的监控和互联网等业务，AI 应用在医学、商业领域的新应用不断增加。而 AI 算法在自然语言处理（NLP）任务上的进步也推动了机器翻译、人机对话、智能文本分析等应用的推广。同时，由 AI 应用所带动的 AI 硬件市场也以两位数的年增速在不断增长。现阶段，按基本功能划分，AI 芯片可分为训练芯片和推理芯片；按技术路径划分，AI 芯片可分为 GPU、FPGA、ASIC 芯片；从终端应用场景来看，除了传统的视频监控和互联网等业务，AI 芯片在医学、商业领域的新应用不断增加。

目前 AI 应用仍然处于算法快速迭代、对算力要求不断提高的阶段，包括 GPU、AI 加速卡、CPU、FPGA 在内的各类 AI 硬件也在迭代发展。客户最关注的是单位价格带来的 AI 算力规模及其功耗成本。数据中心的 AI 硬件部署目前仍然以 GPU 为主，但近两年来各类 AI 专用的训练、推理硬件已经开始规模部署，并在相应场景下展现出功耗、性能、成本等方面的优势。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）内存接口芯片及内存模组配套芯片

公司的内存接口芯片受到了市场及行业的广泛认可，公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，是全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。

产品标准制定方面，公司是全球微电子行业标准制定机构 JEDEC 固态技术协会的董事会成员之一，在 JEDEC 下属的三个委员会及分会中担任主席职位，深度参与 JEDEC 相关产品的标准制定。其中，公司牵头制定 DDR5 第一子代、第二子代内存接口芯片（RCD/DB）的标准，并积极参与 DDR5 内存模组配套芯片标准制定。

技术实力方面，公司处于国际领先水平。公司发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC 国际标准采纳，该架构在 DDR5 世代演化为“1+10”框架，继续作为 LRDIMM 的国际标准。在 DDR5 世代，公司在内存接口芯片方面继续保持技术领先，进一步巩固了在该领域的优势，报告期内，公司与合作伙伴共同研发的内存模组配套芯片成功量产，并且公司已开展 DDR5 第二子代内存接口芯片的研发工作，研发进度目前亦处于行业领先。

市场份额方面，公司在 DDR4 世代逐步确立了行业领先优势，是全球可提供 DDR4 内存接口芯片的三家主要厂商之一，占据全球市场的重要份额。在 DDR5 世代，公司继续领跑，内存接口芯片的市场份额保持稳定。公司可为 DDR5 系列内存模组提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案，是目前全球可提供全套解决方案的两家公司之一。

（2）PCIe Retimer 芯片

公司是全球可